

SiCパワートランジスタリーク箇所の Slice&view(3D-SEM)による故障解析

SEM像の3D化でリークパスを確認

測定法 : Slice & View・EMS

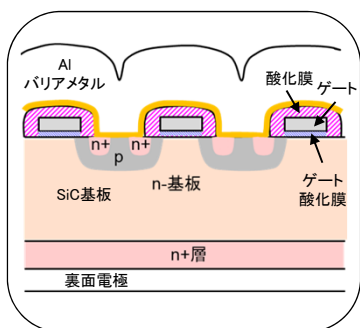
製品分野 : パワーデバイス

分析目的 : 故障解析・不良解析・製品調査

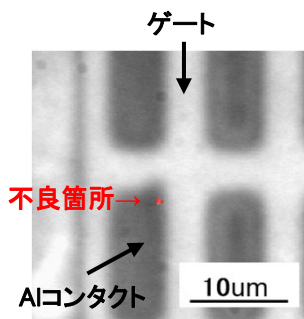
概要

裏面エミッション顕微鏡でリーク箇所を特定したSiCトランジスタについて、Slice & Viewによる断面SEM観察を行いました。Slice & Viewでは、リーク箇所周辺から数十nmオーダーのピッチで断面観察を行うことにより、リーク箇所を逃さず画像として捉えることが可能です。SEM画像を3D化することでリークパスを確認することができます。

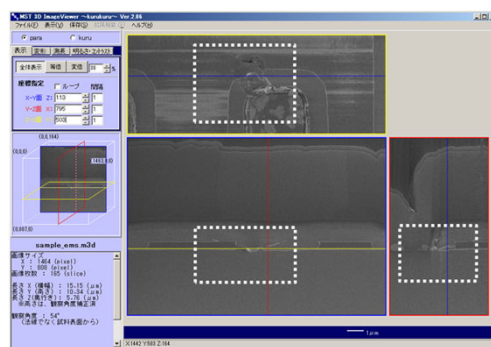
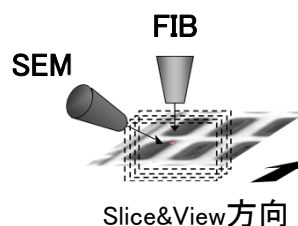
データ



SiCパワートランジスタの模式図

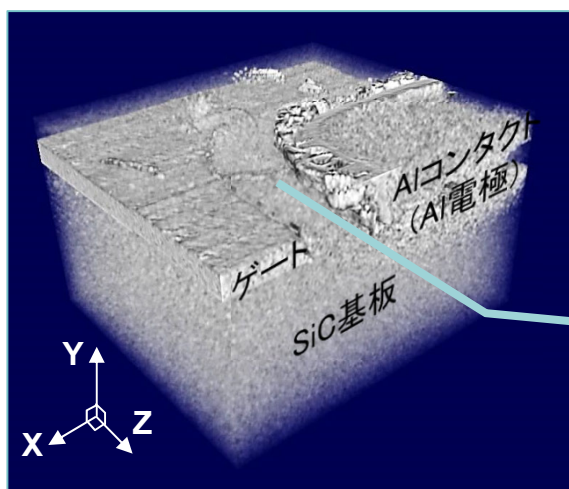


エミッション発光像

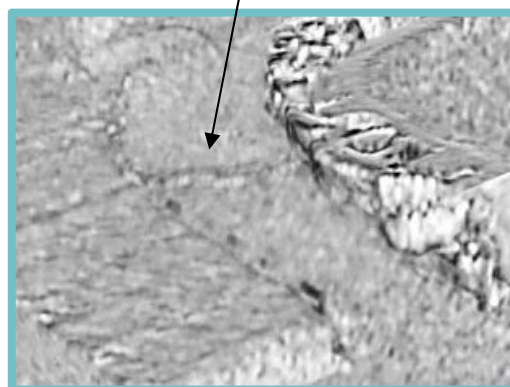


リーク箇所のSlice & View画像

3D化



リークパス



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>